

证券代码：001270

证券简称：铖昌科技

## 浙江铖昌科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：20230330

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与单位	东方阿尔法、中欧基金、工银瑞信、国寿资产、宝盈基金、太平资产、大成基金、国寿安保、银华基金、人寿资管、朱雀基金、浙商资管、长江资管、国君资管、中航信托、杭银理财、天治基金、民生加银、泰信基金、惠升基金、华富基金、海通证券、中金证券、中泰证券、长江证券、东方证券、民生证券、广发证券、西南证券、中信证券、浙商证券、招商证券、兴业证券、盛宇投资、光大证券、俊腾投资、华安通信、神农投资、恒生前海、首钢投资、上海聆泽、世诚投资、棣增投资、昊一基金、雷可澳投资、四叶草资产、嘉沃投资、乐信投资、华夏未来资本、敦和资管、瑞腾投资、开域资产、源峰资管、中大君悦、复需资产
上市公司接待人员姓名	总经理：王立平 副总经理、董事会秘书：赵小婷 证券事务代表：朱峻瑶
时间	2023年3月29日、2023年3月30日
地点	公司会议室
形式	现场调研
交流内容及具体	一、公司基本情况简介

## 问答记录

公司主营业务为微波毫米波模拟相控阵 T/R 芯片（以下简称“相控阵 T/R 芯片”）的研发、生产、销售和技术服务，主要向市场提供基于 GaN、GaAs 和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业之一。目前公司产品已批量应用于星载、地面、机载、车载相控阵雷达及卫星互联网等领域。

2022 年，公司整体经营业绩保持较好的增长趋势，实现营业收入 27,778.84 万元，较上年同期增长 31.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,213.76 万元，较上年同期增长 6.34%；归属于上市公司股东的净利润 13,274.95 万元，较上年同期 15,997.53 万元有所下降，主要原因系 2021 年非经常性损益金额合计为 5,452.35 万元，其中包含当期收到的增值税退税 3,318.54 万元，2022 年度非经常性损益为 2,061.18 万元所致。

公司 2022 年度所得税费用为 947.26 万元，相比 2021 年度所得税费用-538.91 万元，同比增加 1,486.17 万元，主要因公司享受重点集成电路设计企业所得税税收优惠 2021 年度免征所得税，2022 年度所得税税率为 10%所致。剔除所得税费用的影响，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相比上年同期增长 20.02%。

目前，公司已系统性掌握相控阵 T/R 芯片的核心技术，促进了相控阵 T/R 芯片在相关领域的低成本、大规模应用。公司将继续紧抓行业发展的契机，积极研发新产品、开发新客户、拓展新业务领域。

## 二、问答环节

### 1、公司的研发投入逐年上升，如何有效布局？

答：近年来，公司不断加大研发投入，注重自主创新

及核心技术能力的提升，2022 年公司研发投入总额为 4,328.26 万元，较 2021 年度同比增长 45.29%，研发投入占营业收入比例 15.58%。

公司在研发投入的布局上主要分为两个方面，一方面结合客户对芯片产品的功能和性能等需求，依托积累的技术与经验，持续迭代升级已有产品系列，不断提升性能、保持产品的技术先进性及成本优势，为下游应用提供更全面、完整的产品解决方案；另一方面公司坚持技术引领方向，重点把握市场发展趋势，在前瞻性技术应用领域进行布局，加强技术预研产品的开发，提升产品应用性能等，进一步提高产品的竞争力并为下游客户提升产品性能助力。

## **2、请介绍下公司产品的工艺情况以及产品特点？**

答：公司产品主要包含功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、模拟波束赋形芯片及相控阵用无源器件等，产品具备高性能、高集成度和高可靠性等特点。射频电路受限于摩尔定律程度较小，强调的是高输出功率、高可靠性和稳定性，公司产品的工艺制程属于成熟制程范围，能够提供各典型频段的微波毫米波模拟相控阵系统芯片解决方案。

公司功率放大器芯片主要采用 GaAs、GaN 工艺，具有宽禁带、高电子迁移率、高压高功率密度的优势，对于幅相控制类芯片，公司研制的产品采用 GaAs 和硅基两种工艺，其中 GaAs 工艺芯片产品在功率容量、功率附加效率、噪声系数等指标上具备优势，硅基工艺芯片产品则在集成度、低功耗和量产成本方面具备优势。

**3、请简要介绍公司生产的流程，产能扩充方面有什么规划？**

答：公司产品生产流程主要包括晶圆流片、测试、划片、捡片、取样、目检、复检等环节，其中晶圆的流片、划片主要采用代工的模式完成，即公司将自主研发设计的集成电路版图交由晶圆流片厂进行晶圆流片，经公司测试后，再由划片厂进行划片。由此，公司在产能扩张上也更灵活。

基于发展战略和经营需要，公司自 2023 年起向杭州镓谷科技有限公司租赁房屋建筑面积共计 6,751.75 平方米，经营场所的扩充有利于公司产能及生产效率的提升，进一步满足公司业务发展的需要，同时公司加速扩充销售及研发测试人员，为公司的长远发展提供人力资源保障；在设备采购方面，2022 年公司采购设备金额为 7,187.97 万元，为后续的产能扩充提供了研发测试储备，有利于进一步扩大公司的研发及生产规模，满足公司业务快速发展需要。

#### **4、产品应用领域的拓展情况如何？**

答：基于公司的技术积累和行业口碑的建立，与客户合作关系日渐巩固，公司不仅拓展了在星载领域产品应用的卫星型号数量，卫星互联网用相控阵 T/R 芯片也已进入量产阶段，形成公司新的业务增长点。另外公司参与的多个地面领域研制项目陆续进入量产阶段，为营收提供了有力的支撑，机载、舰载等应用领域的产品数量亦有所增长，产品结构逐渐丰富。

#### **5、公司在卫星互联网领域产品优势及进展？**

答：公司积极把握行业发展趋势，领先推出星载和地面用卫星互联网相控阵 T/R 芯片全套解决方案，研制的多通道多波束幅相多功能芯片为代表的 T/R 芯片，在集成度、功耗、噪声系数等关键性能上具备一定的领先优势，为进一步扩大市场份额奠定坚实基础。目前，公司卫星互联网

	<p>相控阵 T/R 芯片产品已进入量产阶段并持续交付中。</p> <p><b>6、2022 年公司地面领域产品体量增速较快，请介绍地面领域产品情况？</b></p> <p>答：公司的地面产品主要以各类型地面雷达为主，具有相控阵阵面大、T/R 通道数量多、探测距离远的特点，其中公司新产品 GaN 功率放大器芯片已实现规模应用，GaN 功率放大器芯片具有体积小、宽禁带、耐高压、耐高温、高功率密度等多方面优势，可满足高功率相控阵雷达的应用场景。</p> <p><b>7、随着公司不断拓展应用领域，后续的毛利率情况如何？</b></p> <p>答：公司主营的相控阵 T/R 芯片产品为相控阵雷达的重要组成部分，具有集成度高、结构复杂、性能参数指标严苛等特征，毛利水平相对较高。</p> <p>公司不同应用领域产品的毛利率存在差异，2022 年度毛利率的波动主要是因为公司的产品结构有一些变化。早期公司星载相控阵 T/R 芯片销售占比较高，该领域具有系统复杂、发射成本高、技术难度高、可靠性要求高和不可维护等特征，因此产品也相应地具有高性能、高附加值的特点。随着公司前期布局的各领域项目逐步量产，地面领域产品快速起量，产品线逐渐丰富，综合毛利率虽有一定的波动，但总体趋于稳定。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使</p>	<p>无</p>

用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	
---------------------------	--